
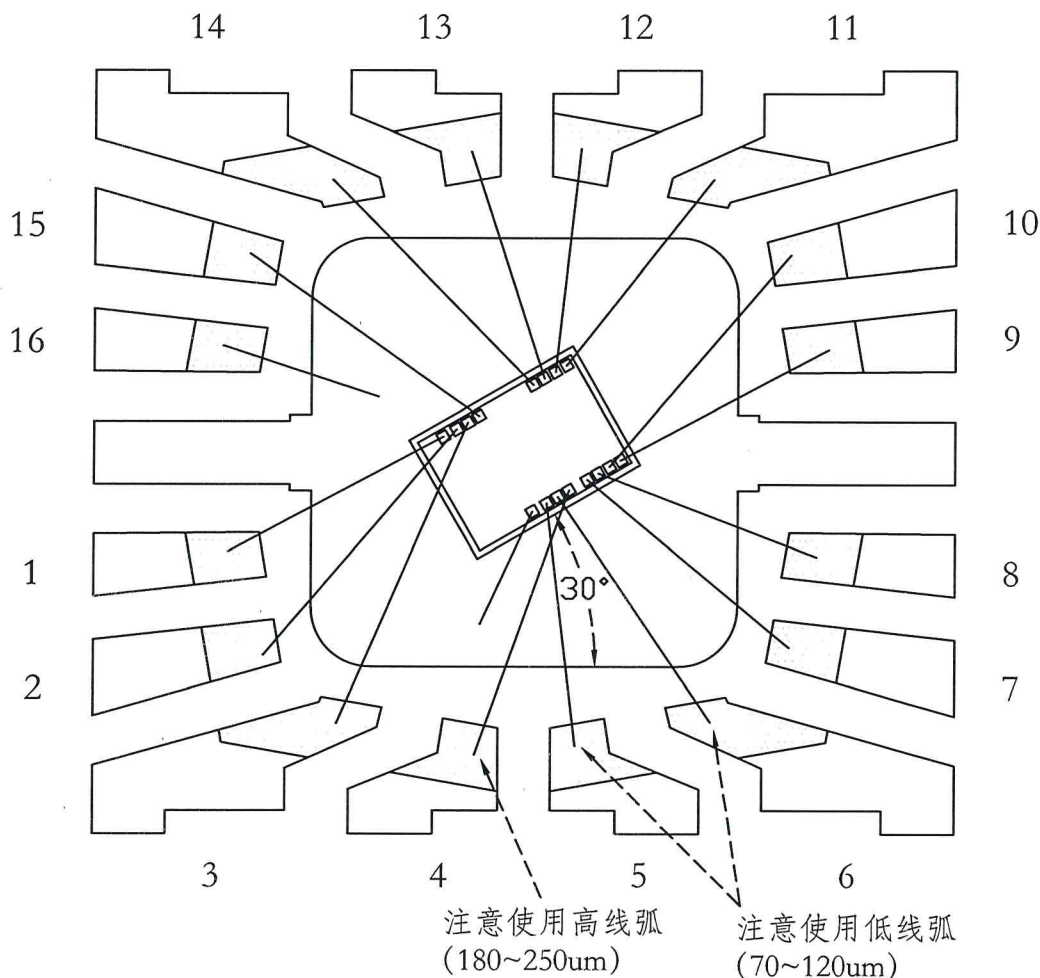
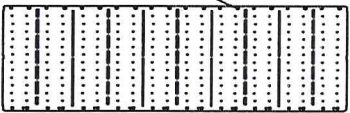


<div>池州华宇电子科技有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div>				客户代码 Customer No.	008	线图号 Drawing No.	HY-PX-008-808 A	
焊线图纸 Bonding Diagram				产品名称 Product Type	HS16P2811TM		封装外型 PKG Type	SOP16L(12R)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	17	23971	1557	588	首选(Preferred): CEL-1702HF 备选(Optional): EME-G630AY		SOP16L-12R (80*80mil²) 2032*2032um²
客户图号 Customer drawing NO.								



拖架传送方向(装片): L/F Direction (D/A): 椭圆孔	实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions: DB注意: 1.芯片居中放置并逆时针旋转30°; 2.控制溢胶,为WB预留焊线位置
 注意:基岛全镀银		

说明 Instructions	粘片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否激光 切割 If Laser?	减薄厚度 (μm) Wafer Thickness
A芯: DIE A	绝缘胶 (Non-conductive) S305D	HS6002	590*835(um²) 23.23*32.87(mil²)	49*49	61	1.2	是/Yes	60	12	否	200
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											
拟制 Prepared by	制图日期 Create Date		2024/11/9		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature					
研发审核 R&D Check	产品工程审核 PE Check				批准 Approved by						